

Title (en)  
HIGH FREQUENCY COIL AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME.

Title (de)  
HOCHFREQUENZSPULE UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG.

Title (fr)  
BOBINE HAUTE FREQUENCE ET PROCEDE POUR SA FABRICATION.

Publication  
**EP 0484558 A1 19920513 (EN)**

Application  
**EP 91909800 A 19910524**

Priority  
• JP 9100698 W 19910524  
• JP 13664790 A 19900525

Abstract (en)  
A high frequency coil having a structure in which strip-like coil conductors are formed on the surfaces of an insulating substrate, and a method of manufacturing the coil. An object of the invention is to increase the Q value of the coil without increasing the film thickness and wire width of the coil conductors. A pair of coil conductors (3, 4) are so formed that the coil conductors sandwich an insulating substrate (1). The paired coil conductors (3, 4) are so connected in parallel to each other that currents flow through them in the same direction. The ends of the paired coil conductors (3, 4) are connected electrically with an input and an output electrode (5, 6) formed on the insulating substrate (1).

Abstract (fr)  
Sont décrits une bobine haute fréquence présentant une structure dans laquelle des conducteurs en forme de bande sont formés sur les surfaces d'un substrat isolant, ainsi qu'un procédé pour fabriquer la bobine. Un objet de l'invention est d'augmenter la valeur Q de la bobine sans augmenter l'épaisseur de film et la largeur de fil des conducteurs de la bobine. Une paire de conducteurs de bobine (3, 4) sont formés de manière à prendre en sandwich un substrat isolant (1). Les deux conducteurs de bobine (3, 4) sont reliés l'un à l'autre en parallèle de sorte que les courants circulent à travers eux dans le même sens. Les extrémités des deux conducteurs de bobine (3, 4) sont reliées électriquement à une électrode d'entrée et à une électrode de sortie (5, 6) formées sur le substrat isolant (1).

IPC 1-7  
**H01F 17/00**; **H01F 41/04**

IPC 8 full level  
**H01F 17/00** (2006.01); **H01F 41/04** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**H01F 17/0006** (2013.01); **H01F 41/045** (2013.01); **H01F 2017/0066** (2013.01)

Cited by  
EP1320109A1; GB2272109A; EP1498913A1; EP1008997A1; EP1047132A1; FR2792775A1; US6891462B2; US6657530B2; US10468753B2; US6784518B1; WO2017052327A1

Designated contracting state (EPC)  
DE FR GB

DOCDB simple family (publication)  
**WO 9119303 A1 19911212**; DE 69111569 D1 19950831; DE 69111569 T2 19960321; EP 0484558 A1 19920513; EP 0484558 A4 19930630; EP 0484558 B1 19950726; JP H0430406 A 19920203

DOCDB simple family (application)  
**JP 9100698 W 19910524**; DE 69111569 T 19910524; EP 91909800 A 19910524; JP 13664790 A 19900525